半導体デバイス・プロセス開発支援センター

~姫路工学キャンパスオープンファシリティの紹介~



工学研究科 電子情報工学専攻

の教授 神田 健介、教授 豊田 紀章

キーワード

半導体製造装置、評価装置、微細加工、リソグラフィ、エッチング、成膜、MEMS、共用設備





研究概要

半導体製造装置および評価装置について、学内共同利用設備の紹介です。工学研究科では JST-ERATO 前中プロジェクト(2008-2013 年)において導入した設備(図1)を中心に、産学、学内外問わず幅広く装置公開してきました(図2)。昨年度から「半導体デバ

イス・プロセス開発支援センター」と名称を改め、より広範な分野からのアクセスを期待しております。設備のご利用についてはタイトル横の QR コードからセンターWeb サイトをご覧ください。オペトレや依頼加工も承っております。気軽に利用可能な皆さまの研究支援ツールとして、是非ご検討ください。

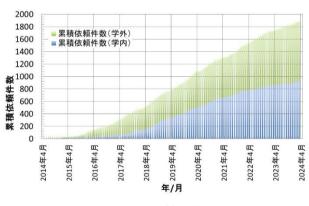


図2 利用状況



図1 共用利用設備の一部

アピールポイント

基本的には設備をご自身操作してご利用いただくスキームとなっております。初回および操作が不安な方には技術員によるオペトレを実施可能です(有料)。学内含む非営利団体のご利用は通常の半額の利用料となります。請求については、学内であれば教員研

究費の移動、もしくは手数料はかかりますが、AffordSNS 社(http://www.affordsens.com/)による代理請求も可能です。タイトル横の QR コードの Web サイト中、「機器使用連絡フォーム」からご希望設備の利用予約をお願いいたします。弊センター技術員より予約の可否についてご連絡差し上げます。